

前奏曲-晶圓裝卸分類系統 PRELUDE

精確安全地由晶圓運送盒取放超薄/翹曲/標準晶圓

提供自動化解決方案由晶圓太空八口盒或蛋糕盒 (wafer shipping box) 取放晶圓傳送至 Cassette/ FOUP/ FOSB, 防止因人工作業造成的污染或破片。

系統將偵測盒內晶圓距離, 可安全地由晶圓之正面進行取/放, 系統可分辨多種材及顏色之隔離資料 (Separator), 並偵測重疊之隔離紙以放於正確之位置。可依晶圓的位置或ID進行分類 (sort: transfer/split/merge)。裝卸速度每小時80片, 可升級到120片。

符合SEMI之多種平臺及陞級配備; 僅需加購尺寸更換配件即可6", 8", 12"晶圓共用。符合的SECS / GEM標準通訊機能; 亦可加清洗站或目檢站或與其它檢測設備 (例如顯微鏡) 綜合; 我們亦可翻修您廠內之傳統晶圓分揀機陞級到特殊晶圓包裝分揀機。

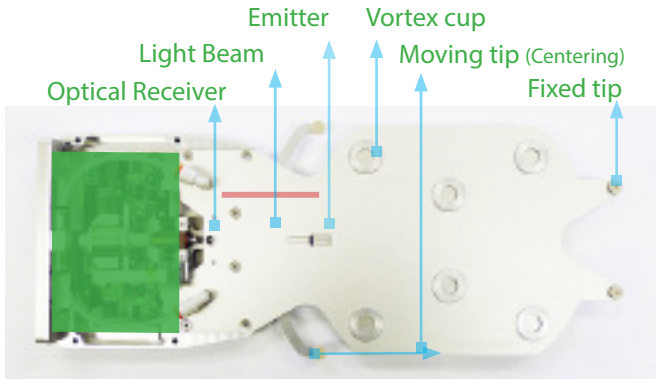
FEATURE

- Highly configurable platform
- Vortex "contactless" wafer handling
- Configurable for most containers types
- Common platform design for all wafer sizes; compact footprint
- End-of-line configurability

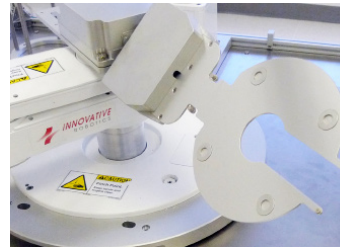


可傳輸50-1600 μ m翹曲, 土豆片類似之晶圓

安全卸片



傳輸翹曲之晶圓系統偵測晶圓位置，當夾爪下移至距盒內晶圓約2.5毫米時自動停下並開啟渦旋式機構（vortex）配有智慧型輕觸式機能（SoftTouch）以隨時微調抓取力（0.3N ~ 9N）

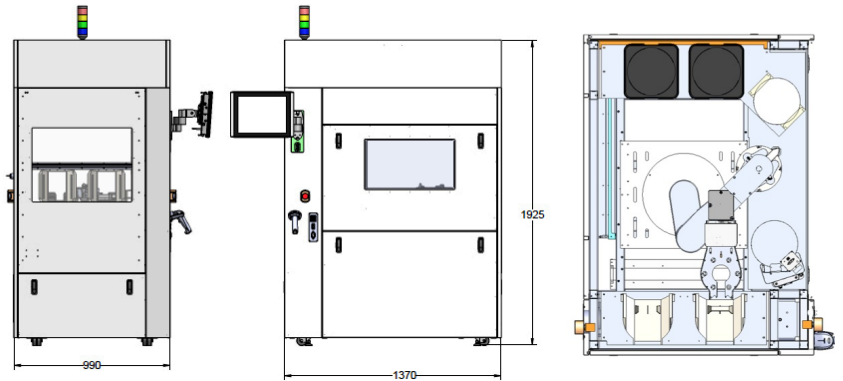


Stress-free晶圓定位器具有智慧輕觸（Soft-Touch）機構以隨時微調抓取力

標準配備

- * 4", 6", 8"或12"; 正反面取放標準厚度之晶圓; 多種材質及顏色之隔離紙
- * 適用於太空八角盒 (canister)
- * 2個canister ports
- * 1個carrier (cssette/ auto FOUP) port
- * 一套機器手加翻轉軸 (Flipper)
- * 高智慧“輕觸”旁抓型之渦旋式夾爪
- * 速度: 每小時~80片
- * 自動檢測其位置有放運送盒等載具
- * 檢測運送盒空格/疊片/斜片
- * 符合SECS / GEM Protocol

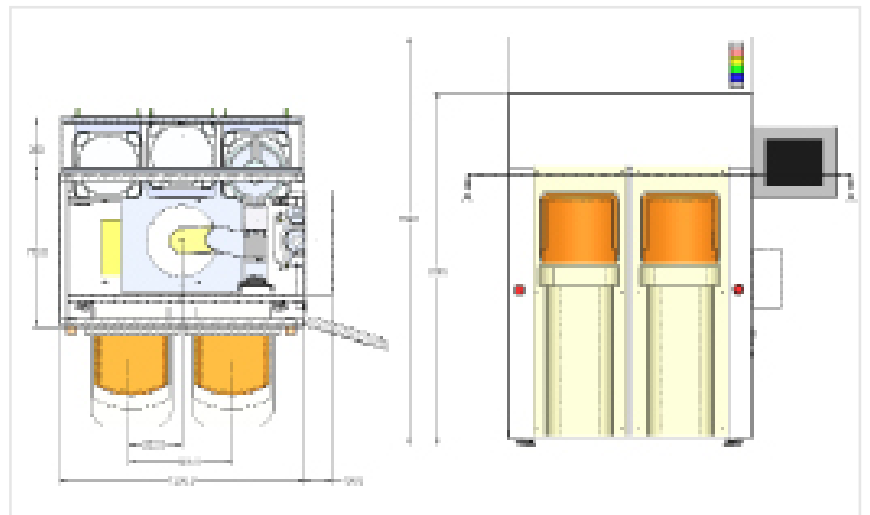
4"~8" LAYOUT (約 1370 x 990 x 2000mm)



昇等配備

- * 可正反面取放50微米到1500微米厚之晶圓; 貼玻璃, 馬鈴薯片型及翹曲, 有洞之晶圓翹曲和下垂 (Warp/ Sag) 可高達8毫米
- * 提高工作速度: 每小時~120片
- * 可選SMIF
- * 加高效率空氣過濾風箱 (Fan Filter Unit; FFU) 及除靜電Ionizer
- * 可新增canister或carrier port
- * 多尺寸共用型
- * 真空+旁觸型定位器或旁觸型定位器;
- * 晶圓ID (OCR, 條碼, 二維條碼) 雙面讀取或晶圓運送盒ID
- * 適用於無開口式晶圓蛋糕盒 (jar)
- * SECS / GEM通訊

12" LAYOUT (約 1400 x 1050 x 2040mm)



QUARTET MECHANICS INC.
 email: inquiry@quartetmechanics.com / www.quartetmechanics.com
 4055 Clipper Court, Fremont, CA 94538, USA
 P +1.510.490.1886 / F +1.510.490.1887

**Quartet
MECHANICS**

亞洲地區請洽詢 周先生 +86.173.0165.2253 / Email: nchou@quartetmechanics.com